



Die Mechatronik Allianz Sachsen veranstaltet den

AllMeSa-Day Allianztag der Mechatronik

Donnerstag, 25.02.2021

VORTRÄGE

zu Produkten der Zukunft aus der High-Performance-Mechatronik Technologieführerschaft mit Teilnehmern aus Industrie und Wissenschaft

Weitere Informationen und die Online-Anmeldemaske finden Sie auf: www.iavt.de/allmesa
Anmeldung bitte bis 19.02.2021

AllMeSa I MECHATRONIK ALLIANZ SACHSEN

Die AllMeSa-Technologieführerschaft realisiert mit durchgängigen High-Performance-Fertigungstechnologien weltweit Anlagen und Produkte.

Die AllMeSa-Schlüsseltechnologien mit mechatronischen Komponenten, Baugruppen und Verfahren partizipieren am Wachstumsmarkt der Mechatronik [Sensorik, Aktorik, Elektronik].

Die AllMeSa Partner-Allianz deckt die progressiv steigende Komplexität von Produkten und Technologien ab und entwickelt aus dem regionalen Kompetenznetzwerk das passende Produkt.

AllMeSa I Kontakt

Dr.-Ing. Robin Schulze
SITEC Industrietechnologie GmbH
Bornaer Str. 192
09114 Chemnitz
Tel.: +49 371 4708-359
Fax: +49 371 4708-240
E-Mail: info@allmesa.network



AllMeSa I Allianzpartner

SITEC SITEC Industrietechnologie GmbH, Chemnitz

XENON XENON Automatisierungstechnik GmbH, Dresden

Adenso Adenso Industrial Services GmbH, Dresden
.solutions you need

i2s i2s Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH, Dresden
an Amphenol company

kontron Kontron AIS GmbH, Dresden
S&T Group

sunfire sunfire GmbH, Dresden

vitesco Vitesco Technologies GmbH
TECHNOLOGIES

Fraunhofer Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden
IWS

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN TU Dresden – Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik, Dresden

ITW ITW e.V. Chemnitz, Chemnitz
CHEMNITZ

AGENDA AllMeSa DaY

Donnerstag, 25.02.2021

8:45 Anmeldung
9:00 Informationen zur Ablauforganisation
9:15 Eröffnung durch Dr. Robin Schulze, SITEC
Industrietechnologie GmbH

Keynote-Vorträge

9:30 *Mechatronische Komponenten und deren Anwendung in Hydrogelen*
Prof. Dr. Gerlach, TU Dresden

10:00 *Kombination von flexibler Elektronik und mechatronischen Systemen*
Dr. Gronarz, Organic Electronics Saxony e.V.

10:30 *Advances in numerical simulations of automotive electronics*
Przemyslaw J. Gromala, Robert Bosch GmbH

11:00 Q&A

11:15 Pause (15min)

Kurzdarstellung der AllMeSa Verbundprojekte

11:30 *Neuartige Herstellungs- und Prüftechnologien für MEMS-Druckzellenwandler*
Benjamin Reichelt, XENON
Automatisierungstechnik GmbH

11:40 *Neuartige Druckzellen-Strukturierung mittels Laserbearbeitung*
Gert Springer, i2s Intelligente Sensorsysteme
Dresden GmbH

11:50 *Glas-Sensorik für den Brennstoffzellen/ Elektrolyse-Stack*
Uwe Beier, Adenso Industrial Services GmbH

12:00 Pause (60min)

AllMeSa-Parallel-Sessions

13:00-14:45

(Details Seite 3)

Session 1

Neuartige Herstellungs- und Prüftechnologien für MEMS-Druckzellenwandler

Session 2

Neuartige Druckzellen-Strukturierung mittels Laserbearbeitung

Session 3

Glas-Sensorik für den Brennstoffzellen/Elektrolyse-Stack

14:45 Pause (15min)

Keynote-Vorträge

15:00 *Zukünftige Softwarelösungen für Maschinenumrüstungen - ohne spezielle Programmierkenntnisse*
Dr. Neubert, HYDRIVE Engineering GmbH

15:30 *Advanced High Density Rigid Packaging Substrates for RF and Miniaturization*
Daniel Schulze, Dyconex AG

16:00 *Trägersubstrate aus Biopolymeren für Elektronikanwendungen?*
Prof. Bauer, HTW Dresden

16:30 Q&A

16:45 Ausblick und Zusammenfassung

AllMeSa Gastredner und Vorträge



Mechatronische Komponenten und deren Anwendung in Hydrogelen
Prof. Dr. Gerlach, TU Dresden,
Institut für Festkörperelektronik



Kombination von flexibler Elektronik und mechatronischen Systemen
Dr. Gronarz, Geschäftsführer und Clustermanager
OES Organic Electronics Saxony e.V.



Advances in numerical simulations of automotive electronics
Przemyslaw Jakub Gromala, Engineering Battery
Management Systems and New Products
Robert Bosch GmbH



Zukünftige Softwarelösungen für Maschinenumrüstungen – ohne spezielle Programmierkenntnisse
Dr. Neubert, Geschäftsführer
HYDRIVE ENGINEERING GmbH, Freital



Advanced High Density Rigid Packaging Substrates for RF and Miniaturization
Daniel Schulze, Dyconex AG



Trägersubstrate aus Biopolymeren für Elektronikanwendungen?
Prof. Bauer, HTW Dresden / Sächsischer
Arbeitskreis Elektronik-Technologie

Block 3 - AllMeSa-Vorträge in Parallel-Sessions

13:00-14:45

Session 1

Moderation: Benjamin Reichelt

Neuartige Herstellungs- und Prüftechnologien für MEMS-Druckzellenwandler

13:00 *Entwicklung von automatisierten Fertigungsprozessen für die Herstellung eines Sensor-Subassembly – Schwerpunkt: Handlingsysteme*
Benjamin Reichelt, XENON Automatisierungstechnik GmbH

13:15 *Entwicklung eines mittels reaktivem Fügen produzierbaren Drucktransmitters mit MEMS-Druckzelle (Produktdemonstrator)*
Dr. Karsten Sager, i2s Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH

13:30 *Entwicklung von Kontaktierungs- und Prüftechnologien für reaktiv gefertigte MEMS-Druckzellen*
Prof. Bernd Hommel, ITW Chemnitz e.V.

13:45 Pause (15min)

14:00 *Entwicklung von reaktiven Pasten zum Fügen von Materialien*
Lukas Stepien, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden

14:15 *Entwicklung eines cloudbasierten Produktionssteuerungssystems*
Thomas Dreyer, Kontron AIS GmbH

14:30 Q&A

Session 2

Moderation: Dr. Karsten Meier

Neuartige Druckzellen-Strukturierung mittels Laserbearbeitung

13:00 *Entwicklung eines Druckmessdemonstrators mittels Laserstrukturierter Edelmembran Druckzellen und Zuverlässigkeitsuntersuchungen*
Gert Springer, i2s Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH

13:15 *Technologische Analysen für die Entwicklung neuer Dünnschicht-Drucksensoren*
Dr. Karsten Meier, TU Dresden, IAVT- Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

13:30 Q&A Teil 1

14:00 *Technologieuntersuchung zur laserbasierten Strukturierung von Druckmesszellen-Membranen*
Dominique Schubert, SITEC Industrietechnologie GmbH

14:15 *Entwicklung von automatisierten Fertigungsprozessen für die Herstellung von laserstrukturierten Edelmembran-Druckmesszellen*
Benjamin Reichelt, XENON Automatisierungstechnik

14:30 Q&A Teil 2

Session 3

Moderation: Dr. Robin Schulze

Glas-Sensorik für den Brennstoffzellen/Elektrolyse-Stack

13:00 *Rolle-zu-Rolle-Verfahren zur Fertigung biegsamer Glas-Sensorik für einen breiten Temperaturbereich*
Uwe Beier, Adenso Industrial Services GmbH

13:15 *Technologiebewertung und Anlagenkonzepte zur Bearbeitung ultradünner Glassubstrate (UTG) mittels Laser*
Dr. Robin Schulze, SITEC Industrietechnologie GmbH

13:30 *Optimierter Brennstoffzellen/Elektrolyse-Stack mit integrierter Glas-Sensorik*
Dr. Ludwig Reichel, sunfire GmbH

14:00 *Reaktives Löten von Glassubstraten auf Basis reaktiver Folien*
Prof. Bernd Hommel, ITW e.V. Chemnitz

14:15 *Technologieentwicklung für hochtemperaturfähige Elektronik auf dünnen Glassubstraten*
Philip Knoch, TU Dresden, IAVT- Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

14:30 Q&A